

御 得 意 様 各位

無料 Web セミナー  
AIと電子産業の進化を支える基板技術を探る！  
技術の実現に欠かせないドライフィルムレジストはく離の急所を解説

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、11月21日にWebセミナーを実施する運びとなりました。  
開催概要やご参加の方法は下記の通りとなります。

**【開催概要】**

昨今、急速に進化しているAIなどの情報・コミュニケーション技術の発展を支えるプリント配線板やパッケージ基板、およびチップレット実装を実現する上で欠かせないドライフィルムレジストの課題について解説し、最後に課題解決のためのドライフィルムレジストはく離剤についてご説明いたします。

開催日：2024年11月21日（木）  
時間：11:00～ 11:40（約40分）  
※日本時間

費用：無料  
形式：Webセミナー（Zoom使用）

**注意事項：同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。**

**【お申し込み方法】**

下記リンク先のお申し込みフォームよりご登録ください。

<https://www.meltex.com/registration.html>

**注意事項：同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。**

なお、Webセミナーや、その他弊社製品についてのご質問がございましたら、下記のお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。

■お問合せフォーム

<https://www.meltex.com/contact.html>

今後ともよろしく願いいたします。

敬具